

2020-2026年中国LED封装行业前景展望与投资前景评估报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2020-2026年中国LED封装行业前景展望与投资前景评估报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202008/180885.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

LED是发光二极管(LightEmittingDiode)的简称,是一种固态半导体发光器件。通过在LED两端加载电压,将电能直接转换为光能,大大降低了能量转换过程中的损耗,LED因此被称为第四代照明光源或绿色光源。其具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,可以广泛应用于照明、背光、指示显示等领域。LED产业包括上游衬底制作、外延生长和芯片制造,中游封装和下游应用市场。LED封装形式多样,根据不同的应用场合采用不同的外形尺寸、散热对策和出光效果,可分为LampLED、SMDLED、COB、FlipChip等。

就封装市场来看,2019年国内市场规模达963亿,同比增长29%。预计2018-2020中国LED封装行业将维持13%-15%的增速,2020年产值规模将达1288亿元。借助于国内劳动力的成本优势和政府的产业优惠政策,全球LED封装产业加快向大陆转移。国首尔半导体、三星、CREE、Lumileds等国外品牌大厂将代工订单逐渐往中国集中,中国成为LED全球产能中心。

中企顾问网发布的《2020-2026年中国LED封装行业前景展望与投资前景评估报告》共十二章。首先介绍了中国LED封装行业市场发展环境、LED封装整体运行态势等,接着分析了中国LED封装行业市场运行的现状,然后介绍了LED封装市场竞争格局。随后,报告对LED封装做了重点企业经营状况分析,最后分析了中国LED封装行业发展趋势与投资预测。您若想对LED封装产业有个系统的了解或者想投资中国LED封装行业,本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 LED封装相关概述

第一节 LED封装简介

一、LED封装作用

二、LED封装的形式

三、LED封装的工艺流程

四、LED封装对封装材料要求

第二节 LED封装的常见要素

一、LED引脚成形方法

二、LED弯脚及切脚

三、LED清洗

四、LED过流保护

五、LED焊接条件

第三节 LED封装的结构类型

一、封装结构的类型

二、引脚式封装

三、表面贴装封装

四、功率型封装

五、COB型封装

第二章 全球LED封装行业发展现状与前景分析

第一节 2013-2019年世界LED封装业的发展总况

一、世界LED封装业发展规模及应用

二、世界LED封装企业分析

三、世界LED封装技术先进性分析

第二节 主要地区LED封装行业发展分析

一、美国LED封装行业发展分析

二、日本LED封装行业发展分析

三、韩国LED封装行业发展分析

四、台湾LED封装行业发展分析

第三节 全球LED封装行业发展趋势与前景

一、全球LED封装行业发展趋势分析

二、全球LED封装行业发展前景预测

第四节 全球LED封装行业发展趋势与前景

一、CREE（科锐）

二、NICHIA（日亚化学）

三、飞利浦（Philips）

四、三星LED（Samsung LED）

五、首尔半导体（SSC）

六、略

第三章 2013-2019年中国LED封装行业市场发展环境分析

第一节 2013-2019年中国宏观经济环境分析

- 一、中国GDP分析
- 二、消费价格指数分析
- 三、城乡居民收入分析
- 四、社会消费品零售总额
- 五、全社会固定资产投资分析
- 六、进出口总额及增长率分析

第二节 2013-2019年中国LED封装行业政策环境分析

- 一、《LED封装工艺与生产管理》
- 二、LED封装工艺规范
- 三、LED封装行业一揽子政策发布在即
- 四、补贴政策将出LED封装市场可期
- 五、《半导体照明节能产业发展意见》
- 六、《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》
- 七、《国家“十三五”科学和技术发展规划》

第三节 2013-2019年中国LED封装行业技术环境分析

第四章 2013-2019年中国LED封装产业整体运营现状分析

第一节 中国LED封装行业发展现状分析

- 一、中国LED封装行业发展历程
- 二、中国LED封装行业发展现状

第二节 2013-2019年中国LED封装业的发展综述

- 一、中国LED封装业发展成果
- 二、产值增长情况
- 三、产量增长情况
- 四、价格分析
- 五、利好因素

第三节 2013-2019年国内重要LED封装项目的建设进展

- 一、韩企投资扬州兴建LED封装基地
- 二、西安经开区LED封装线项目投产
- 三、长治高科LED封装项目竣工投产

四、敬亭园中园LED支架及封装项目开建

五、源力光电LED封装线正式投产

第四节 SMD LED封装

一、SMD LED封装市场发展简况

二、LED封装技术壁垒较高

三、SMD LED封装产能尚未过剩

四、SMD LED封装受益于芯片价格下降

第五节 2013-2019年中国LED封装业发展中存在的热点问题探讨

一、制约我国LED封装业发展的因素

二、国内LED封装企业面临的挑战

三、封装业销售额与海外企业差距明显

四、传统封装工艺成为系统成本瓶颈

第六节 促进中国LED封装业发展的策略

一、做大做强LED封装产业的对策

二、发展LED封装行业的措施建议

三、LED封装业发展需加大研发投入

四、我国LED封装业应向高端转型

第五章 2013-2019年中国LED封装行业市场分析

第一节 2013-2019年中国LED封装市场规模分析

一、2013-2019年中国LED封装行业市场规模及增速

二、2013-2019年中国LED封装行业市场饱和度

三、2020-2026年中国LED封装行业市场规模及增速预测

第二节 2013-2019年中国LED封装行业市场供需分析

一、2013-2019年中国LED封装行业市场需求分析

二、2013-2019年中国LED封装行业市场供给分析

三、2013-2019年中国LED封装行业进出口分析

四、2013-2019年中国LED行业价格分析

第三节 2013-2019年中国LED封装市场发展态势

一、中国成中低端LED封装重要基地

二、国内LED封装企业发展不平衡

三、中国LED封装市场缺乏大型企业

四、LED产业上游厂商涉足封装市场

五、台湾LED封装产能向大陆转移

第四节 中国LED封装企业分布状况

第五节 广东省LED封装业

一、主要特点

二、重点市场

三、发展趋势

第六章 2013-2019年中国LED封装地区市场情况分析

第一节 LED封装“东北地区”市场情况分析

一、2013-2019年东北地区发展情况分析

二、2013-2019年东北地区市场需求情况分析

第二节 LED封装“华北地区”市场情况分析

一、2013-2019年华北地区发展情况分析

二、2013-2019年华北地区市场需求情况分析

第三节 LED封装“华南地区”市场情况分析

一、2013-2019年华南地区发展情况分析

二、2013-2019年华南地区市场需求情况分析

第四节 LED封装“华东地区”市场情况分析

一、2013-2019年华东地区发展情况分析

二、2013-2019年华东地区市场需求情况分析

第五节 LED封装“西北地区”市场情况分析

一、2013-2019年西北地区发展情况分析

二、2013-2019年西北地区市场需求情况分析

第六节 LED封装“西南地区”市场情况分析

一、2013-2019年西南地区发展情况分析

二、2013-2019年西南地区市场需求情况分析

第七节 LED封装“华中地区”市场情况分析

一、2013-2019年华中地区发展情况分析

二、2013-2019年华中地区市场需求情况分析

第七章 2013-2019年中国LED封装行业技术研发进展状况

第一节 中国LED封装技术分析

- 一、LED封装产品技术
- 二、LED封装技术原理
- 三、LED封装结构及技术
- 四、国内中游上市公司各自优势
- 五、LED的封装步骤及技术要领
- 六、大功率LED封装结构及技术原理透析
- 七、大功率白光LED封装技术面临的挑战

第二节 中国LED封装技术发展概况

- 一、封装技术影响LED产品可靠性
- 二、中外LED封装技术的差异
- 三、中国LED业专利集中在封装领域
- 四、中国LED封装业的技术特点
- 五、LED封装技术水平不断提升
- 六、LED封装业技术研发仍需加强

第三节 LED封装关键技术介绍

- 一、大功率LED封装的关键技术
- 二、显示屏用LED封装的技术要求
- 三、固态照明对LED封装的技术要求

第八章 2013-2019年中国LED封装设备及封装材料的发展

第一节 LED封装设备市场分析

- 一、我国LED封装设备市场概况
- 二、LED封装设备国产化亟需加速
- 三、发展我国LED封装设备业的思路

第二节 LED封装材料市场分析

- 一、LED封装主要原材介绍
- 二、我国LED封装材料市场简析
- 三、部分关键封装原材料仍依赖进口
- 四、LED封装用基板材料市场走向分析
- 五、LED封装支架市场 91

第三节 国内LED封装支架市场格局分析

- 一、LED封装支架技术未来发展趋势
- 二、我国LED封装支架市场前景广阔

第九章 2013-2019年中国LED封装产业竞争新形态分析

第一节 2013-2019年中国LED封装市场竞争格局

- 一、中国采购影响世界封装市场格局
- 二、我国LED封装市场各方力量简述
- 三、国内LED封装市场竞争加剧
- 四、本土LED封装企业整合步伐加速

第二节 2013-2019年中国LED封装企业集中度分析

- 一、2013-2019年中国LED封装企业集中度分析
- 二、2019年本土LED封装企业竞争力排名

第三节 2020-2026年中国LED封装竞争趋势预测分析

第十章 2019年中国LED封装部分企业经营分析

第一节 国星光电

第二节 瑞丰光电

第三节 源磊科技

第四节 鸿利光电

第五节 雷曼光电

第六节 宁波升谱光电半导体有限公司

第七节 南京汉德森科技股份有限公司

第八节 大族光电

第九节 厦门信达

第十节 亿光电子

第十一章 2020-2026年中国LED封装发展趋势及前景

第一节 2020-2026年LED封装未来发展趋势

- 一、功率型白光LED封装技术发展趋势
- 二、LED封装技术将向模块化方向发展
- 三、LED封装产业未来发展走向分析

第二节 2020-2026年中国LED封装市场前景展望

- 一、我国LED封装市场发展前景乐观
- 二、LED封装产品应用市场将持续扩张
- 三、中国LED通用照明封装市场规模预测

第十二章 2020-2026年中国LED封装投资前景预测

第一节 2020-2026年中国LED封装投资概况

- 一、LED封装行业投资特性
- 二、LED封装具有良好的投资价值
- 三、LED封装投资环境利好

第二节 2020-2026年中国LED封装投资机会分析

- 一、LED封装投资热点（LED封装、LED封装电视）
- 二、国家节能减排衍生LED封装投资机会

第三节 2020-2026年中国LED封装投资风险及防范

- 一、技术风险分析
- 二、金融风险分析
- 三、政策风险分析
- 四、竞争风险分析

第四节 建议

图表目录：

图表 LED封装行业产业链

图表 2012-2019年LED封装行业市场供给

图表 2012-2019年LED封装行业市场需求

图表 2012-2019年LED封装行业市场规模

图表 2012-2019年中国LED封装行业市场规模及增速

图表 2012-2019年中国LED封装行业重点企业市场份额

图表 2019年中国LED封装行业渠道结构

图表 2012-2019年中国LED封装行业需求总量

图表 2012-2019年中国LED封装行业需求集中度

图表 2012-2019年中国LED封装行业需求增长速度

图表 2012-2019年中国LED封装行业市场饱和度

图表 2012-2019年中国LED封装行业供给总量

图表 2012-2019年中国LED封装行业供给增长速度

图表 2012-2019年中国LED封装行业供给集中度

图表 2012-2019年中国LED封装行业销售量

图表 2012-2019年中国LED封装行业库存量

更多图表见正文.....

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202008/180885.html>